

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-45℃～ + 125℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～ + 60℃（注2）	
	電 圧	150 V AC	適合コネクタ	DF9#-*S-1V(22)	
	電 流	0.5 A		DF9#-*S-1V(32)	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観、構造、仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電気的 性能	接触抵抗	100 mA(DC又は 1000 Hz)で測定する。	50 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 100 Vで測定する。	500 MΩ以上	○	—
機械的 性能	耐電圧	AC 250 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗：50 mΩ以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗：50 mΩ以下 ②絶縁抵抗：500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -65 → 5～35 → 125 → 5～35℃ 時間 30 → 10～15 → 30 → 10～15分 を 5 サイクル 試験する。	①接触抵抗：50 mΩ以下 ②絶縁抵抗：500 MΩ以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	半田耐熱性	【 リフロー半田付けの場合 】 《 リフロー部 》 MAX 250℃ピーク 220℃以上 60 秒 以内 《 予熱部 》 150～180℃ 90～120 秒 リフローは同条件にて2回まで可能 【 手半田（リペア）の場合 】 半田ごてで 380℃、3秒の条件にて半田付け を行う。但し、端子に力を加えないこと。	外観の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。	○	—
	はんだ付け性	はんだ温度245±5℃、浸漬時間3±0.5秒間 のはんだ付けを行う。	はんだ浸漬面の95%以上が新しいはんだで 濡れていること。	○	—
					
備考（注1）通電による温度上昇を含みます。 （注2）保存とは基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表し、基板搭載後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用しています。					
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
	1	DIS-H-001215	AR. TAKAHASHI	TS. MIYAZAKI	06.08.02
			承認	TY. OMA	04.03.01
			検 図	TS. MIYAZAKI	04.03.01
			担 当	HK. UMEHARA	04.03.01
			製 図	HK. UMEHARA	04.03.01
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-160018-10		
	製 品 規 格 表		製品名	DF9B-*P-1V(32)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL540	 1/1